

Epoxy bonding film의 phenoxy resin 함량에 따른 특성 변화

김상현, 이우성, 강남기, 유명재
전자부품연구원, 전자소재 패키징 연구센터

Effect of phenoxy resin content on Properties of Epoxy Bonding Film

Sang-Hyun Kim, Woo Sung Lee, Nam-kee Kang, Myong-Jae Yoo,
korea electronics technology institute, electronics&packaging research center

Abstract : 본 논문에서는 epoxy bonding film의 phenoxy resin의 함량변화에 따른 특성 변화에 대하여 연구하였다. epoxy bonding film은 미세패턴 구현을 위해서 사용되는 기판재료로써 epoxy, hardener, silica, phenoxy resin 등이 첨가되어진다. phenoxy resin 함량을 변화를 주면서 tape casting 방법을 통해서 flim 형성을 한 후, 제작된 film의 phenoxy resin 함량변화에 따른 조도 특성의 연구를 위해서 sweller, desmear 공정을 후 RA(Roughness Average)를 측정하고, SEM으로 표면을 관찰하였다. 또한 제작된 bonding film을 가열·가압 후 구리 도금공정을 거쳐 peel strength를 측정하였다. phenoxy resin 함량이 증가 할수록 RA가 증가되어지는 것이 관찰되어졌고, 또 한 peel strength 증가하였다..

Key Words : epoxy bonding film, phenoxy resin